

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



## HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

### 华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

## 新闻稿

### 二零二四年第一季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2024年5月9日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二四年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。

#### 二零二四年第一季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 4.600 亿美元，上年同期为 6.308 亿美元，上季度为 4.554 亿美元。
- 毛利率 6.4%，上年同期为 32.1%，上季度为 4.0%。
- 母公司拥有人应占溢利 3,180 万美元，上年同期为 1.522 亿美元，上季度为 3,540 万美元。
- 基本每股盈利 0.019 美元，上年同期为 0.116 美元，上季度为 0.021 美元。
- 净资产收益率（年化）2.0%，上年同期为 19.6%，上季度为 2.4%。

#### 二零二四年第二季度指引

- 我们预计销售收入约在 4.7 亿美元至 5.0 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 6%至 10%之间。

## 总裁致辞

公司总裁兼执行董事唐均君先生对二零二四年第一季度业绩评论道：

“华虹半导体二零二四年第一季度销售收入为 **4.60** 亿美元，符合指引预期；单季毛利率为 **6.4%**，略高于指引。”

“整体半导体市场的景气尚未摆脱低迷，且由于季节性和年度维修的影响，第一季度是代工企业的传统淡季，但华虹半导体第一季度的产能利用率、销售收入、毛利率均实现环比提升，验证了公司特色工艺的市场需求总体向好。”

唐总继续讲道：“公司的第一条十二英寸生产线今年全年将在月产能 **9.45** 万片的基础上运行，第二条十二英寸生产线也正在建设过程中，预计将于年底建成投产。我们将紧跟市场趋势，抓住市场机会，持续推进新技术的研发和现有工艺平台的优化和提升，不断强化公司在特色工艺领域的优势，聚焦新质生产力，推动产业生态协同，实现华虹半导体更快和更高质量的发展，以更优异的经营效益和投资回报回馈广大投资者。”

## 电话会议公告

- 日期 2024 年 5 月 9 日，星期四
- 时间: 17:00 香港/上海时间  
05:00 美国东部时间
- 发言人: 唐均君，总裁兼执行董事  
王鼎，执行副总裁兼首席财务官
- 广播: 会议将在 [http://www.huahonggrace.com/c/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php) 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/c543tkq6> 作线上直播  
(请提前注册登记)
- 电话直拨: 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。  
<https://register.vevent.com/register/BI96355b5c2077430bb0e4455877ac11c5>  
**重要提示:** 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。
- 网上重播: 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。  
[http://www.huahonggrace.com/c/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php)

## 关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等“8 英寸 + 12 英寸”特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 月产能约 18 万片。另在无锡高新技术产业开发区内建有一座月产能 9.45 万片的 12 英寸晶圆厂 (“华虹无锡”), 这不仅是全球领先的 12 英寸特色工艺生产线, 也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前, 本公司正在推进华虹无锡二期 12 英寸芯片生产线 (“华虹制造”) 的建设。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

**经营业绩概要**  
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	459,986	630,842	455,361	(27.1)%	1.0 %
<b>毛利</b>	<b>29,632</b>	<b>202,197</b>	<b>18,220</b>	<b>(85.3)%</b>	<b>62.6 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>6.4 %</b>	<b>32.1 %</b>	<b>4.0 %</b>	<b>(25.7)</b>	<b>2.4</b>
经营开支	(78,520)	(76,261)	(95,063)	3.0 %	(17.4)%
其他收入净额	3,770	6,066	87,600	(37.9)%	(95.7)%
<b>税前(损失)/溢利</b>	<b>(45,118)</b>	<b>132,002</b>	<b>10,757</b>	<b>(134.2)%</b>	<b>(519.4)%</b>
所得税抵免/(开支)	19,832	8,900	(7,210)	122.8 %	(375.1)%
<b>期内(损失)/溢利</b>	<b>(25,286)</b>	<b>140,902</b>	<b>3,547</b>	<b>(117.9)%</b>	<b>(812.9)%</b>
<b>净利润率</b>	<b>(5.5)%</b>	<b>22.3 %</b>	<b>0.8 %</b>	<b>(27.8)</b>	<b>(6.3)</b>
以下各方应占利润:					
母公司拥有人	31,818	152,234	35,386	(79.1)%	(10.1)%
非控股权益	(57,104)	(11,332)	(31,839)	403.9 %	79.4 %
持有人应占每股盈利					
基本	0.019	0.116	0.021	(83.6)%	(9.5)%
摊薄	0.019	0.115	0.021	(83.5)%	(9.5)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,026	1,001	951	2.5 %	7.9 %
产能利用率 <sup>1</sup>	91.7 %	103.5 %	84.1 %	(11.8)	7.6
净资产收益率 <sup>2</sup>	2.0 %	19.6 %	2.4 %	(17.6)	(0.4)

**二零二四年第一季度**

- 销售收入 4.600 亿美元, 上年同期为 6.308 亿美元, 主要由于平均销售价格下降, 较上季度增长 1%。
- 毛利率 6.4%, 上年同期为 32.1%, 主要由于平均销售价格下降及产能利用率降低, 较上季度上升 2.4 个百分点, 主要由于产能利用率提升。
- 经营开支 7,850 万美元, 同比上升 3.0%, 主要由于研发工程片开支增加, 环比下降 17.4%, 主要由于上季度计提年终奖金所致。
- 其他收入净额 380 万美元, 同比下降 37.9%, 主要由于本季度为汇兑损失而上年同期为汇兑收益, 部分被利息收入增加所抵消, 环比下降 95.7%, 主要由于政府补贴下降以及本季度为汇兑损失而上季度为汇兑收益。
- 所得税抵免 1,980 万美元, 同比上升 122.8%, 主要由于应课税利润下降。
- 期内损失 2,530 万美元, 上年同期为期内溢利 1.409 亿美元, 上季度为期内溢利 350 万美元。
- 母公司拥有人应占溢利 3,180 万美元, 上年同期为 1.522 亿美元, 上季度为 3,540 万美元。
- 基本每股盈利 0.019 美元, 上年同期为 0.116 美元, 上季度为 0.021 美元。
- 净资产收益率 (年化) 2.0%, 上年同期为 19.6%, 上季度为 2.4%。

<sup>1</sup>产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

<sup>2</sup>母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	二零二三年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	437,060	95.0 %	605,718	96.0 %	(168,658)	(27.8)%
其他	22,926	5.0 %	25,124	4.0 %	(2,198)	(8.7)%
<b>销售收入总额</b>	<b>459,986</b>	<b>100.0 %</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(170,856)</b>	<b>(27.1)%</b>

- 本季度 95.0%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	二零二三年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	239,950	52.2 %	379,584	60.2 %	(139,634)	(36.8)%
12 吋晶圆	220,036	47.8 %	251,258	39.8 %	(31,222)	(12.4)%
<b>销售收入总额</b>	<b>459,986</b>	<b>100.0 %</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(170,856)</b>	<b>(27.1)%</b>

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.400 亿美元及 2.200 亿美元。

### 销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	二零二三年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 <sup>3</sup>	365,695	79.5 %	477,155	75.7 %	(111,460)	(23.4)%
北美 <sup>4</sup>	46,241	10.1 %	70,760	11.2 %	(24,519)	(34.7)%
亚洲 <sup>5</sup>	23,566	5.1 %	39,062	6.2 %	(15,496)	(39.7)%
欧洲	21,739	4.7 %	37,344	5.9 %	(15,605)	(41.8)%
日本 <sup>6</sup>	2,745	0.6 %	6,521	1.0 %	(3,776)	(57.9)%
<b>销售收入总额</b>	<b>459,986</b>	<b>100.0 %</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(170,856)</b>	<b>(27.1)%</b>

- 本季度来自于中国的销售收入 3.657 亿美元，占销售收入总额的 79.5%，同比下降 23.4%，主要由于智能卡芯片、IGBT、和超级结产品平均销售价格及需求下降，部分被 MCU、逻辑、及 CIS 产品需求增加所抵消。
- 本季度来自于北美的销售收入 4,620 万美元，同比下降 34.7%，主要由于 MCU 产品需求及平均销售价格下降，部分被其他电源管理产品的需求增加所抵消。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 2,360 万美元，同比下降 39.7%，主要由于 MCU、通用 MOSFET 及其他电源管理产品的需求减少。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 2,170 万美元，同比下降 41.8%，主要由于智能卡芯片、IGBT 和通用 MOSFET 产品的需求减少。
- 本季度来自于日本的销售收入 270 万美元，同比下降 57.9%，主要由于 MCU 产品的需求减少。

<sup>3</sup>包括中国大陆及中国香港。

<sup>4</sup>包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

<sup>5</sup>不包括中国及日本。

<sup>6</sup>包括于 2013 年由一家总部位于美国的公司所收购的一家主要日本客户。

### 销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	二零二三年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	119,214	25.9 %	239,228	37.9 %	(120,014)	(50.2)%
独立式非易失性存储器	31,072	6.8 %	31,802	5.0 %	(730)	(2.3)%
分立器件	143,344	31.1 %	232,640	36.9 %	(89,296)	(38.4)%
逻辑及射频	64,213	14.0 %	39,203	6.2 %	25,010	63.8 %
模拟与电源管理	101,495	22.1 %	87,535	13.9 %	13,960	15.9 %
其他	648	0.1 %	434	0.1 %	214	49.3 %
<b>销售收入总额</b>	<b>459,986</b>	<b>100.0 %</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(170,856)</b>	<b>(27.1)%</b>

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.192 亿美元，同比下降 50.2%，主要由于 MCU 及智能卡芯片的平均销售价格及需求下降。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 3,110 万美元，同比下降 2.3%。
- 本季度分立器件销售收入 1.433 亿美元，同比下降 38.4%，主要由于 IGBT、超级结、及通用 MOSFET 产品的需求及平均销售价格下降。
- 本季度逻辑及射频销售收入 6,420 万美元，同比增长 63.8%，主要得益于 CIS 及逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.015 亿美元，同比增长 15.9%，主要由于其他电源管理产品的需求增加。

### 销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二四年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第一季度 % (未经审核)	二零二三年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
55nm 及 65nm	94,477	20.6 %	58,514	9.2 %	35,963	61.5 %
90nm 及 95nm	88,516	19.2 %	119,348	18.9 %	(30,832)	(25.8)%
0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m	71,430	15.5 %	128,905	20.4 %	(57,475)	(44.6)%
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	29,912	6.5 %	43,928	7.0 %	(14,016)	(31.9)%
0.25 $\mu$ m	7,617	1.7 %	4,146	0.7 %	3,471	83.7 %
0.35 $\mu$ m 及以上	168,031	36.5 %	276,001	43.8 %	(107,970)	(39.1)%
<b>销售收入总额</b>	<b>459,983</b>	<b>100.0 %</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(170,859)</b>	<b>(27.1)%</b>

- 本季度 55nm 及 65nm 工艺技术节点的销售收入 9,450 万美元，同比增长 61.5%，主要得益于 CIS 及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 8,850 万美元，同比下降 25.8%，主要由于智能卡芯片需求减少，部分被其他电源管理产品需求增加所抵消。
- 本季度 0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m 工艺技术节点的销售收入 7,140 万美元，同比下降 44.6%，主要由于 MCU 产品的平均销售价格下降。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工艺技术节点的销售收入 2,990 万美元，同比下降 31.9%，主要由于 MCU 产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工艺技术节点的销售收入 760 万美元，同比增长 83.7%，主要得益于逻辑产品的需求增加。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工艺技术节点的销售收入 1.680 亿美元，同比下降 39.1%，主要由于 IGBT、超级结、通用 MOSFET 及其他电源管理产品的需求及平均销售价格下降。



### 销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二四年	二零二四年	二零二三年	二零二三年	同比	同比
	第一季度	第一季度	第一季度	第一季度		
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)		
电子消费品	287,863	62.6 %	368,695	58.4 %	(80,832)	(21.9)%
工业及汽车	102,723	22.3 %	180,229	28.6 %	(77,506)	(43.0)%
通讯	61,204	13.3 %	62,809	10.0 %	(1,605)	(2.6)%
计算机	8,196	1.8 %	19,109	3.0 %	(10,913)	(57.1)%
<b>销售收入总额</b>	<b>459,986</b>	<b>100.0 %</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(170,856)</b>	<b>(27.1)%</b>

- 本季度电子消费品作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 2.879 亿美元，占销售收入总额的 62.6%，同比下降 21.9%，主要由于超级结及智能卡芯片的平均销售价格及需求下降，部分被其他电源管理、闪存、逻辑及 CIS 产品的需求增加所抵消。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.027 亿美元，同比下降 43.0%，主要由于 MCU、IGBT、及通用 MOSFET 产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度通讯产品销售收入 6,120 万美元，同比下降 2.6%，主要由于智能卡芯片需求下降，部分被 CIS、模拟、逻辑及射频产品需求增加所抵消。
- 本季度计算机产品销售收入 820 万美元，同比下降 57.1%，主要由于通用 MOSFET 及 MCU 产品需求减少。

### 产能<sup>7</sup>及产能利用率

晶圆厂(折合千片晶圆)	二零二四年	二零二三年	二零二三年
	第一季度	第一季度	第四季度
	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)
产能 (200mm)	178	178	178
产能 (300mm)	95	65	95
<b>合计产能(折合 8 吋千片晶圆)</b>	<b>391</b>	<b>324</b>	<b>391</b>
产能利用率 (200mm)	100.3%	107.1%	91.0%
产能利用率 (300mm)	84.2%	99.0%	77.5%
总体产能利用率	91.7%	103.5%	84.1%

- 本季度末月产能 391,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 91.7%，较上季度上升 7.6 个百分点。

<sup>7</sup>期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

### 付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,026	1,001	951	2.5 %	7.9 %

■ 本季度付运晶圆 1,026,000 片，同比上升 2.5%，环比上升 7.9%。

### 经营开支分析

以千美元计	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	1,985	2,688	2,684	(26.2)%	(26.0)%
管理费用 <sup>8</sup>	76,535	73,573	92,379	4.0 %	(17.2)%
<b>经营开支</b>	<b>78,520</b>	<b>76,261</b>	<b>95,063</b>	<b>3.0 %</b>	<b>(17.4)%</b>

■ 经营开支 7,850 万美元，同比上升 3.0%，主要由于研发工程片开支增加，环比下降 17.4%，主要由于上季度计提年终奖金所致。

### 其他收入净额

以千美元计	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,560	3,464	3,447	2.8 %	3.3 %
利息收入	25,020	11,364	20,182	120.2 %	24.0 %
汇兑(损失)/收益	(5,850)	16,536	27,041	(135.4)%	(121.6)%
分占联营公司溢利	1,411	1,520	7,136	(7.2)%	(80.2)%
财务费用	(24,585)	(28,413)	(19,540)	(13.5)%	25.8 %
政府补贴	3,799	788	51,387	382.1 %	(92.6)%
其他	415	807	(2,053)	(48.6)%	(120.2)%
<b>其他收入净额</b>	<b>3,770</b>	<b>6,066</b>	<b>87,600</b>	<b>(37.9)%</b>	<b>(95.7)%</b>

■ 其他收入净额 380 万美元，同比下降 37.9%，主要由于本季度为汇兑损失而上年同期为汇兑收益，部分被利息收入增加所抵消，环比下降 95.7%，主要由于政府补贴下降以及本季度为汇兑损失而上季度为汇兑收益。

<sup>8</sup>管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

### 现金流量分析

以千美元计	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	40,660	131,868	196,546	(69.2)%	(79.3)%
投资活动所用现金流量净额	(298,951)	(203,281)	(301,916)	47.1 %	(1.0)%
融资活动所得现金流量净额	789,913	263,249	642,297	200.1 %	23.0 %
外汇汇率变动影响净额	(8,817)	17,946	58,753	(149.1)%	(115.0)%
<b>现金及现金等价物变动影响净额</b>	<b>522,805</b>	<b>209,782</b>	<b>595,680</b>	<b>149.2 %</b>	<b>(12.2)%</b>

- 本季度经营活动所得现金流量净额 4,070 万美元，同比下降 69.2%，环比下降 79.3%，主要由于客户收款及政府补助减少所致。
- 投资活动所用现金流量净额 2.990 亿美元，其中包括固定资产及无形资产投资支出 3.026 亿美元，及其他权益工具投资 1,760 万美元，部分被收到利息收入 2,120 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 7.899 亿美元，其中非控股权益资本注资 6.894 亿美元，提取银行借款 1.034 亿美元，及员工行权发行股份收到 10 万美元，部分被支付利息 210 万美元，及支付租赁负债 90 万美元所抵消。

### 资本结构

以千美元计	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (已审核)
资产总额	11,648,010	10,943,420
负债总额	2,980,801	2,928,876
所有者权益总额	8,667,209	8,014,544
资产负债率 <sup>9</sup>	25.6%	26.8%

### 资本开支

以千美元计	二零二四年 第一季度 (未经审核)	二零二三年 第四季度 (未经审核)
华虹 8 吋	31,728	28,761
华虹无锡	71,417	121,918
华虹制造	199,429	180,690
<b>合计</b>	<b>302,574</b>	<b>331,369</b>

- 本季度资本开支 3.026 亿美元，其中 1.994 亿美元用于华虹制造，7,140 万美元用于华虹无锡，及 3,170 万美元用于华虹 8 吋。

<sup>9</sup>资产负债率=负债总额/资产总额。

## 流动性分析

以千美元计	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (已审核)
发展中物业	194,181	178,828
存货	431,206	449,749
贸易应收款项及应收票据	306,151	278,669
预付款项、其他应收款项及其他资产	53,242	33,821
应收关联方款项	15,688	11,219
已冻结存款及定期存款	32,032	32,088
现金及现金等价物	6,107,986	5,585,181
<b>流动资产总额</b>	<b>7,140,486</b>	<b>6,569,555</b>
贸易应付款项	239,261	235,410
其他应付款项及暂估费用	379,133	430,478
计息银行借款	232,201	193,035
租赁负债	6,257	3,076
政府补助	41,643	35,017
应付关联方款项	9,704	13,876
应付所得税	59,018	61,495
<b>流动负债总额</b>	<b>967,217</b>	<b>972,387</b>
<b>净营运资金</b>	<b>6,173,269</b>	<b>5,597,168</b>
速动比率	6.7x	6.1x
流动比率	7.4x	6.8x
贸易应收款项及应收票据周转天数	58	60
存货周转天数	92	97

- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 3,380 万美元上升至本季度末的 5,320 万美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 应收关联方款项由上季度末的 1,120 万美元上升至本季度末的 1,570 万美元，主要由于应收一家关联方的款项增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 4.305 亿美元下降至本季度末的 3.791 亿美元，主要由于本季度支付资本开支款及年终奖金所致。
- 计息银行借款由上季度末的 1.930 亿美元上升至本季度末的 2.322 亿美元，主要由于一年内到期的长期借款增加。
- 政府补助由上季度末的 3,500 万美元上升至本季度末的 4,160 万美元，主要由于政府项目收款增加。
- 应付关联方款项由上季度末的 1,390 万美元下降至 970 万美元，主要由于本季度支付一家关联方技术采购款项。
- 净营运资金 本季度末 61.733 亿美元，流动比率 7.4。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 58 天。
- 存货周转天数 92 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

华虹半导体有限公司  
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)
销售收入	459,986	630,842	455,361
销售成本	(430,354)	(428,645)	(437,141)
<b>毛利</b>	<b>29,632</b>	<b>202,197</b>	<b>18,220</b>
其他收入及收益	32,851	32,970	100,442
投资物业的公平值收益	-	-	103
销售及分销费用	(1,985)	(2,688)	(2,684)
管理费用	(76,535)	(73,573)	(92,379)
其他费用	(5,907)	(11)	(541)
财务费用	(24,585)	(28,413)	(19,540)
分占联营公司溢利	1,411	1,520	7,136
<b>税前(损失)/溢利</b>	<b>(45,118)</b>	<b>132,002</b>	<b>10,757</b>
所得税抵免/(开支)	19,832	8,900	(7,210)
<b>期内(损失)/溢利</b>	<b>(25,286)</b>	<b>140,902</b>	<b>3,547</b>
以下各方应占利润			
母公司拥有人	31,818	152,234	35,386
非控股权益	(57,104)	(11,332)	(31,839)
持有人应占每股盈利			
基本	0.019	0.116	0.021
摊薄	0.019	0.115	0.021
<b>用于计算持有人应占每股基本盈利的     期内已发行普通股加权平均数</b>	<b>1,716,634,650</b>	<b>1,307,286,436</b>	<b>1,716,439,808</b>
<b>用于计算持有人应占每股摊薄盈利的     期内已发行普通股加权平均数</b>	<b>1,718,334,991</b>	<b>1,318,907,456</b>	<b>1,720,215,394</b>

华虹半导体有限公司  
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (已审核)	于三月三十一日 二零二三年 (未经审核)
<b>资产</b>			
<b>非流动资产</b>			
物业、厂房及设备	3,587,363	3,519,292	3,436,656
投资物业	166,354	166,643	171,653
使用权资产	79,347	78,545	84,063
无形资产	46,526	49,827	31,217
于联营公司的投资	140,270	139,099	134,017
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	287,089	270,506	181,597
长期预付款项	200,074	149,953	6,903
递延税项资产	501	-	14,673
<b>非流动资产总额</b>	<b>4,507,524</b>	<b>4,373,865</b>	<b>4,060,779</b>
<b>流动资产</b>			
发展中物业	194,181	178,828	143,960
存货	431,206	449,749	593,922
贸易应收款项及应收票据	306,151	278,669	306,062
预付款项、其他应收款项及其他资产	53,242	33,821	38,657
应收关联方款项	15,688	11,219	15,348
已冻结存款及定期存款	32,032	32,088	1,056
现金及现金等价物	6,107,986	5,585,181	2,218,547
<b>流动资产总额</b>	<b>7,140,486</b>	<b>6,569,555</b>	<b>3,317,552</b>
<b>流动负债</b>			
贸易应付款项	239,261	235,410	220,243
其他应付款项及暂估费用	379,133	430,478	441,795
计息银行借款	232,201	193,035	408,669
租赁负债	6,257	3,076	5,582
政府补助	41,643	35,017	38,165
应付关联方款项	9,704	13,876	7,944
应付所得税	59,018	61,495	98,314
<b>流动负债总额</b>	<b>967,217</b>	<b>972,387</b>	<b>1,220,712</b>
<b>流动资产净额</b>	<b>6,173,269</b>	<b>5,597,168</b>	<b>2,096,840</b>
<b>总资产减流动负债</b>	<b>10,680,793</b>	<b>9,971,033</b>	<b>6,157,619</b>
<b>非流动负债</b>			
计息银行借款	1,993,525	1,906,526	1,496,396
租赁负债	17,714	19,129	19,080
递延税项负债	2,345	30,834	11,463
<b>非流动负债总额</b>	<b>2,013,584</b>	<b>1,956,489</b>	<b>1,526,939</b>
<b>净资产</b>	<b>8,667,209</b>	<b>8,014,544</b>	<b>4,630,680</b>
<b>权益和负债权益</b>			
股本	4,934,028	4,933,559	1,996,528
储备	1,389,777	1,367,436	1,229,318
<b>本公司拥有人应占权益</b>	<b>6,323,805</b>	<b>6,300,995</b>	<b>3,225,846</b>
非控股权益	2,343,404	1,713,549	1,404,834
<b>权益总额</b>	<b>8,667,209</b>	<b>8,014,544</b>	<b>4,630,680</b>

华虹半导体有限公司  
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)
<b>经营活动所得现金流量:</b>			
税前(亏损)/溢利	(45,118)	132,002	10,757
折旧及摊销	133,088	120,338	129,135
应占联营公司溢利	(1,411)	(1,520)	(7,136)
营运资金的变动及其它	(45,899)	(118,952)	63,790
<b>经营活动所得现金流量净额</b>	<b>40,660</b>	<b>131,868</b>	<b>196,546</b>
<b>投资活动所用现金流量:</b>			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(302,574)	(216,620)	(331,369)
投资其他权益工具	(17,618)	-	-
收到政府对物业、厂房及设备的补助	-	-	11,692
其他投资活动所得现金流量	21,241	13,339	17,761
<b>投资活动所用现金流量净额</b>	<b>(298,951)</b>	<b>(203,281)</b>	<b>(301,916)</b>
<b>融资活动所得现金流量:</b>			
非控股权益资本注资	689,430	296,197	491,723
提取银行贷款	103,405	12,972	246,620
偿还银行贷款	-	(42,527)	(54,942)
已付利息	(2,155)	(3,830)	(45,234)
支付租赁负债	(881)	(756)	(274)
发行股份所得收益	114	1,442	1,407
其他融资活动所(用)/得现金流量	-	(249)	2,997
<b>融资活动所得现金流量净额</b>	<b>789,913</b>	<b>263,249</b>	<b>642,297</b>
现金及现金等价物增加净额	531,622	191,836	536,927
外汇汇率变动影响净额	(8,817)	17,946	58,753
期初现金及现金等价物	5,585,181	2,008,765	4,989,501
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>6,107,986</b>	<b>2,218,547</b>	<b>5,585,181</b>

于本公告日期，本公司董事分别为：

**执行董事**

张素心(董事长)  
唐均君(总裁)

**非执行董事**

叶峻  
孙国栋  
周利民  
熊承艳

**独立非执行董事**

张祖同  
王桂坝太平绅士  
封松林

承董事会命

**华虹半导体有限公司**

张素心  
董事长兼执行董事

中国 香港

二零二四年五月九日